­Pressemitteilung

Veröffentlichung vom November 2024, Embedded-Systeme

Embedded Design-In  
Stromsparende Embedded-Speicherlösung mit Automotive Grade 3/2

**Der Value Added Distributor und Lösungsanbieter HY-LINE bietet ab sofort den Ferri-eMMC im Automotive-Temperaturbereich von -40 °C bis 85 / 105 °C an. Die eMMC-Speicherlösung im kompakten BGA-Gehäuse hat die IATF-16949-Lieferketten-Zertifizierung und ist konform zu den Standards AEC-Q100 und Automotive Service Packaging (ASP).**

Die stromsparende Speicherlösung Ferri-eMMC in hochwertiger TLC-NAND-Technologie ist in verschiedenen Kapazitäten von 16 bis 512 GB erhältlich. Dank Automotive Grade 3/2 und einer geringen Stromaufnahme von ca. 70 bis 100 mA ist der lötbare Speicher in kompakten 100/153-Ball-BGA-Gehäusen ideal für anspruchsvolle Automotive-Anwendungen. Möglich ist der Einsatz in IVI-Systemen (IVI = In Vehicle Infotainment), automobilen KI-Anwendungen, aber auch in industriellen Wearables, Handhelds und VR-Geräten für den rauen Outdoor-Einsatz. Der Speicher ist konform zu JEDEC eMMC 5.1. Für die zuverlässige langlebige Datenspeicherung sorgen fortschrittliche NAND-Managementfunktionen wie Bad-Block-Management, Health-Monitoring und Fehlerkorrektur. Über Firmware ist eine kundenspezifische Anpassung an spezielle Funktionen und Anwendungen möglich.

HY-LINE bietet umfassende Unterstützung bei der Integration der Ferri-eMMC-Speicherlösung in Embedded-Anwendungen, bei denen höchste Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Energieeffizienz entscheidend sind.

**Mehr erfahren**Ferri-eMMC:  
<https://www.hy-line-group.com/ferri-emmc>

**Pressebild**

Ein Bild, das Text, Screenshot, Logo, Visitenkarte enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

**A10792-10 PR Ferri-eMMC.jpg**Bildunterschrift:

Die stromsparende Embedded-Speicherlösung Ferri-eMMC im kompakten BGA-Gehäuse gibt es ab sofort bei HY-LINE mit Automotive Grade 3/2

--------------------------------------------------------------------------------------

**SEO**

Ferri-eMMC, Automotive Grade 3/2, Embedded-Speicherlösung, Embedded-Anwendungen, Speicher für IVI, eMMC für automotive KI, eMMC im 100/153-Ball-BGA-Gehäuse, IATF-16949-Zertifizierung, AEC-Q100, Automotive Service Packaging,

--------------------------------------------------------------------------------------

HY-LINE Technology GmbH

Inselkammerstr. 10

82008 Unterhaching

E-Mail: sales@hy-line.de

Tel.: +49 89 614 503 10